

1 2 3 4 5 6 7 8

A

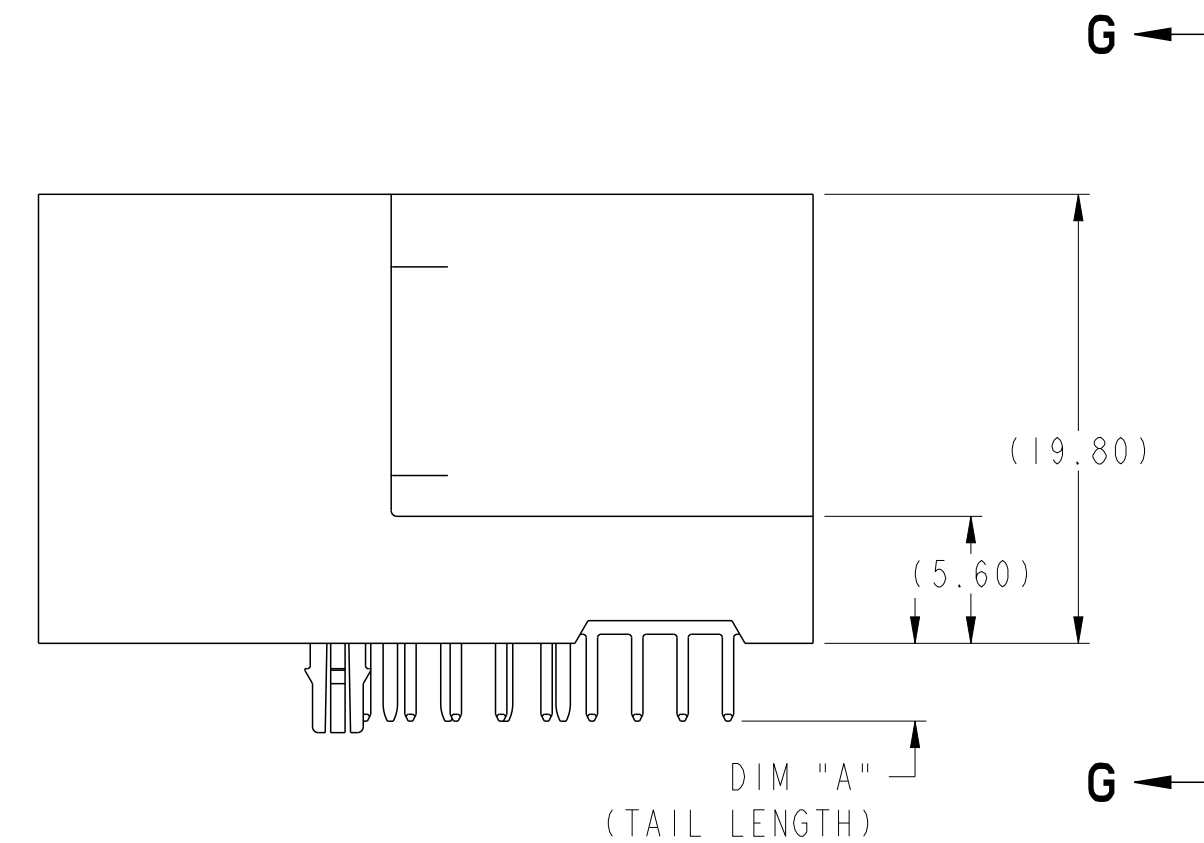
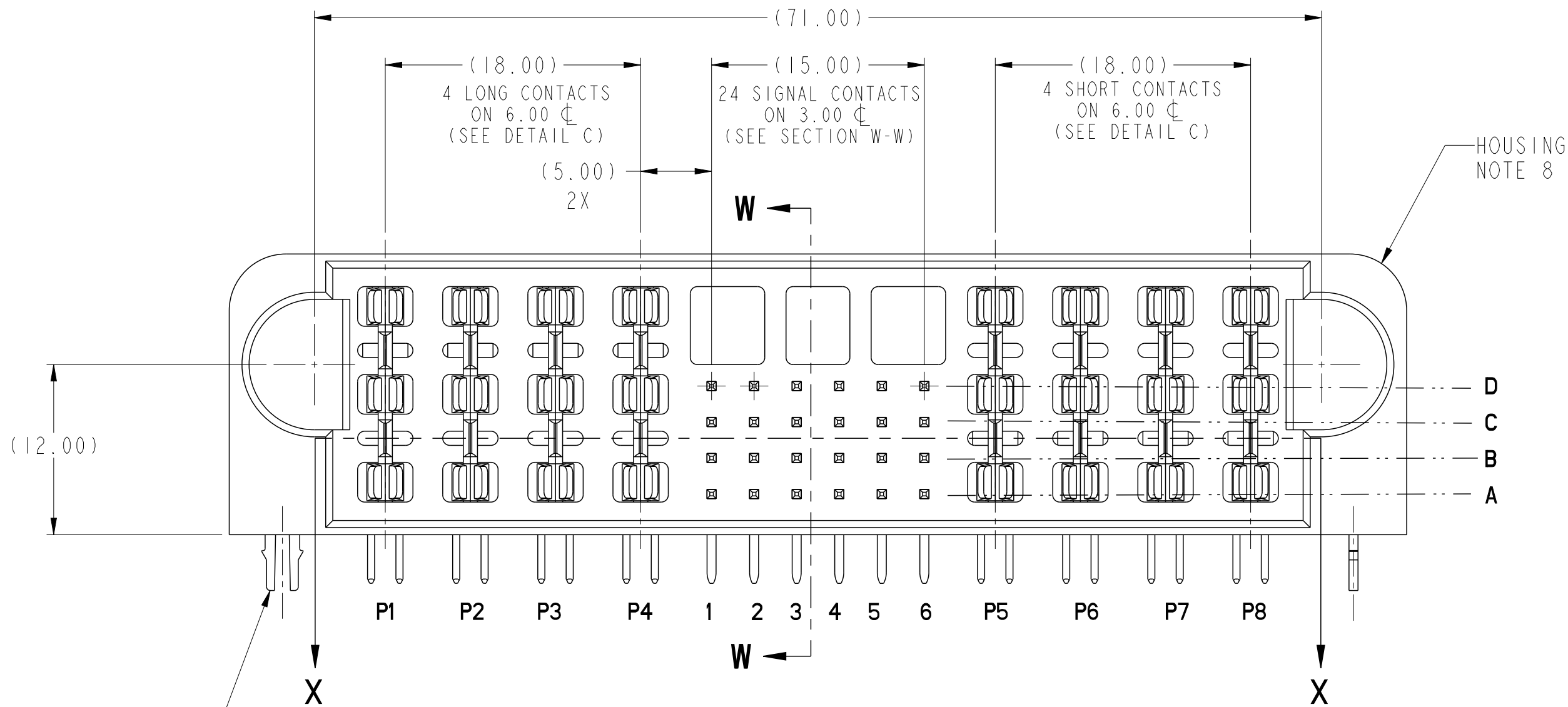
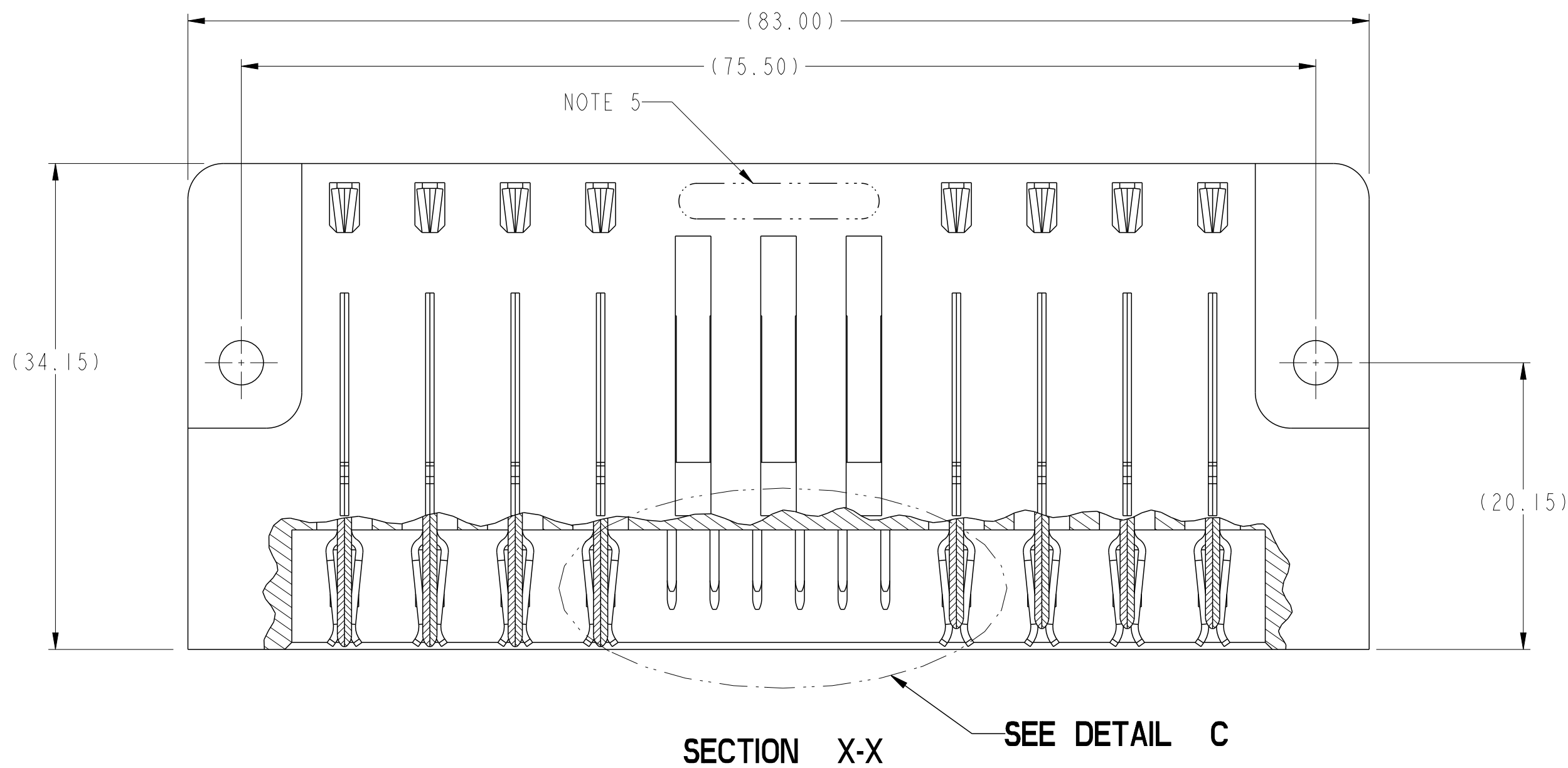
B

C

A

B

C

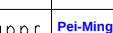


D

E

F

RETENTION CLIPS
OPTIONAL
(SEE P/N TABLE)

spec ref		-		dr		NotFound DuWa		2010/04/28		projection						size		A2		scale		3:1	
tolerance std		-		eng		De-Ming Lu		2014/12/27				MM		ecn no		ELX-DG-19849-1							
ASME Y14.5		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr		-		-						product family		HCI							
				appr		Pei-Ming Zheng		2014/12/29						rel level						Released			
surface				linear		0.X		±0.5				title		R/A HDR ASSY 4P+24S+4P		dwg no		10077213		rev		B	
				0.XX		±0.25																	
				0.XXX		±0.10																	
ASME Y14.5		angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 1 of 5							

PDS: Rev :B

STATUS:Released

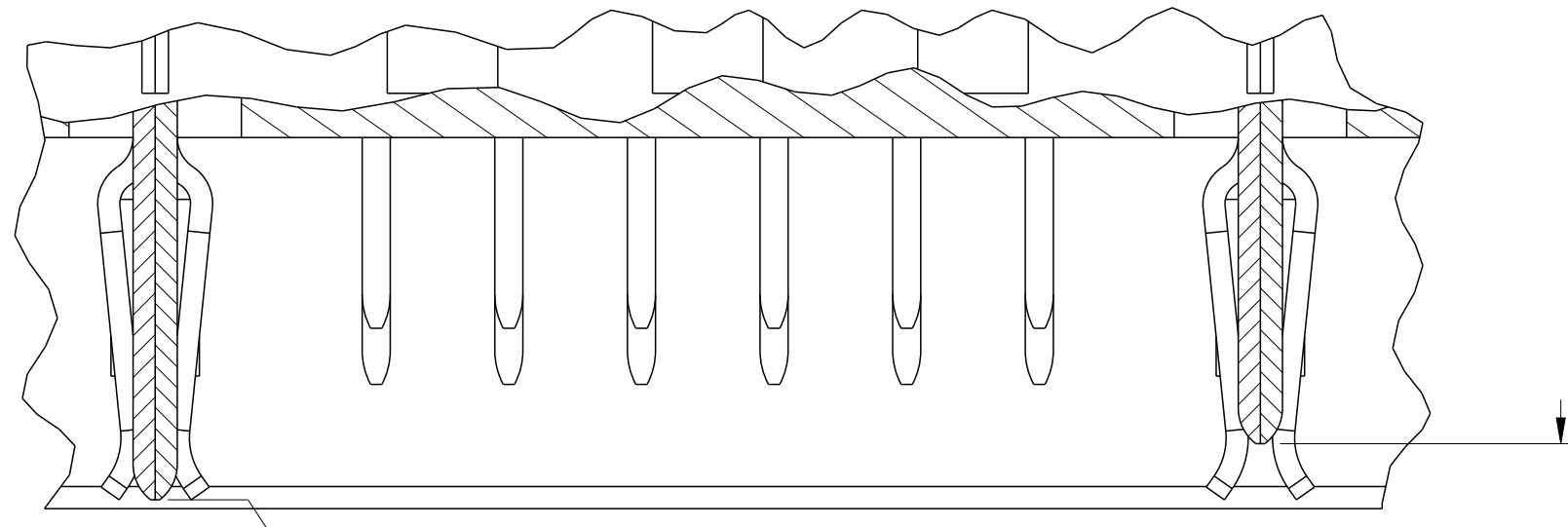
Printed: Dec 30, 2014

2

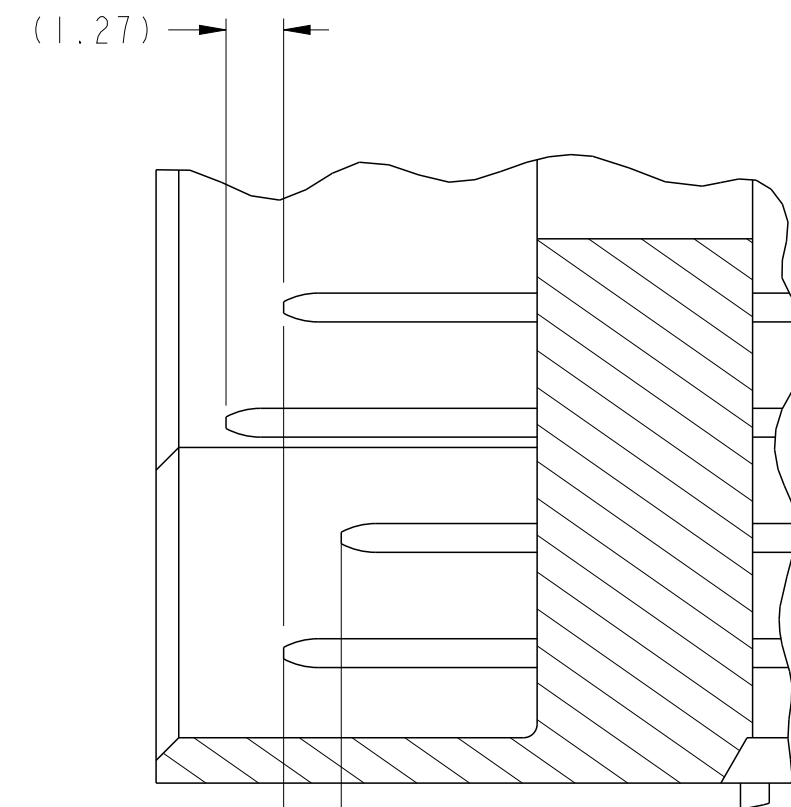
3

4

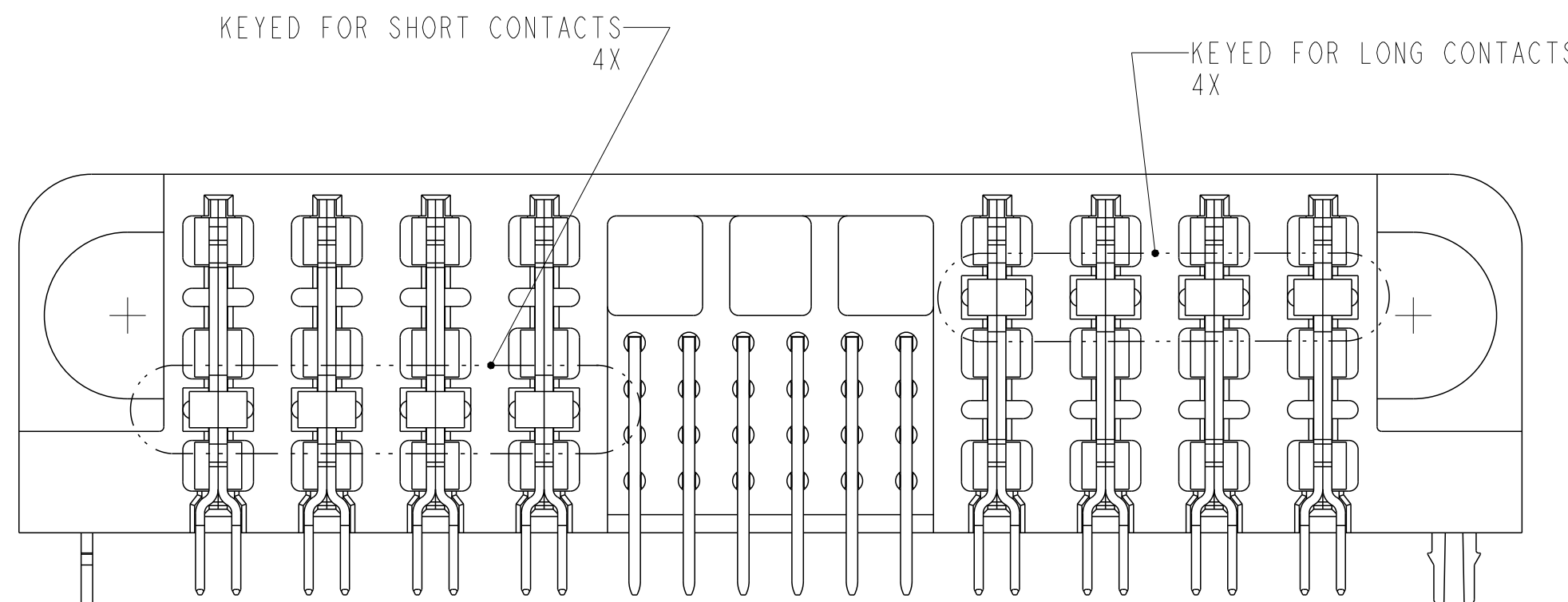
5



DETAIL C
SCALE 6:1
POWER MATING
SEQUENCE



SECTION W-W
SCALE 6:1
SIGNAL MATING
SEQUENCE



VIEW G-G

dr	Not Found DuWa	2010/04/28		MM		size	A2	scale	3:1
eng	De-Ming Lu	2014/12/27				ecn no	ELX-DG-19849-1		
chr	-	-				rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2014/12/29	product family		HCI				
	title	R/A HDR ASSY 4P+24S+4P				dwg no	10077213		rev
		HCI POWER CONNECTOR							
www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw				sheet 2 of 5		

PDS: Rev :B

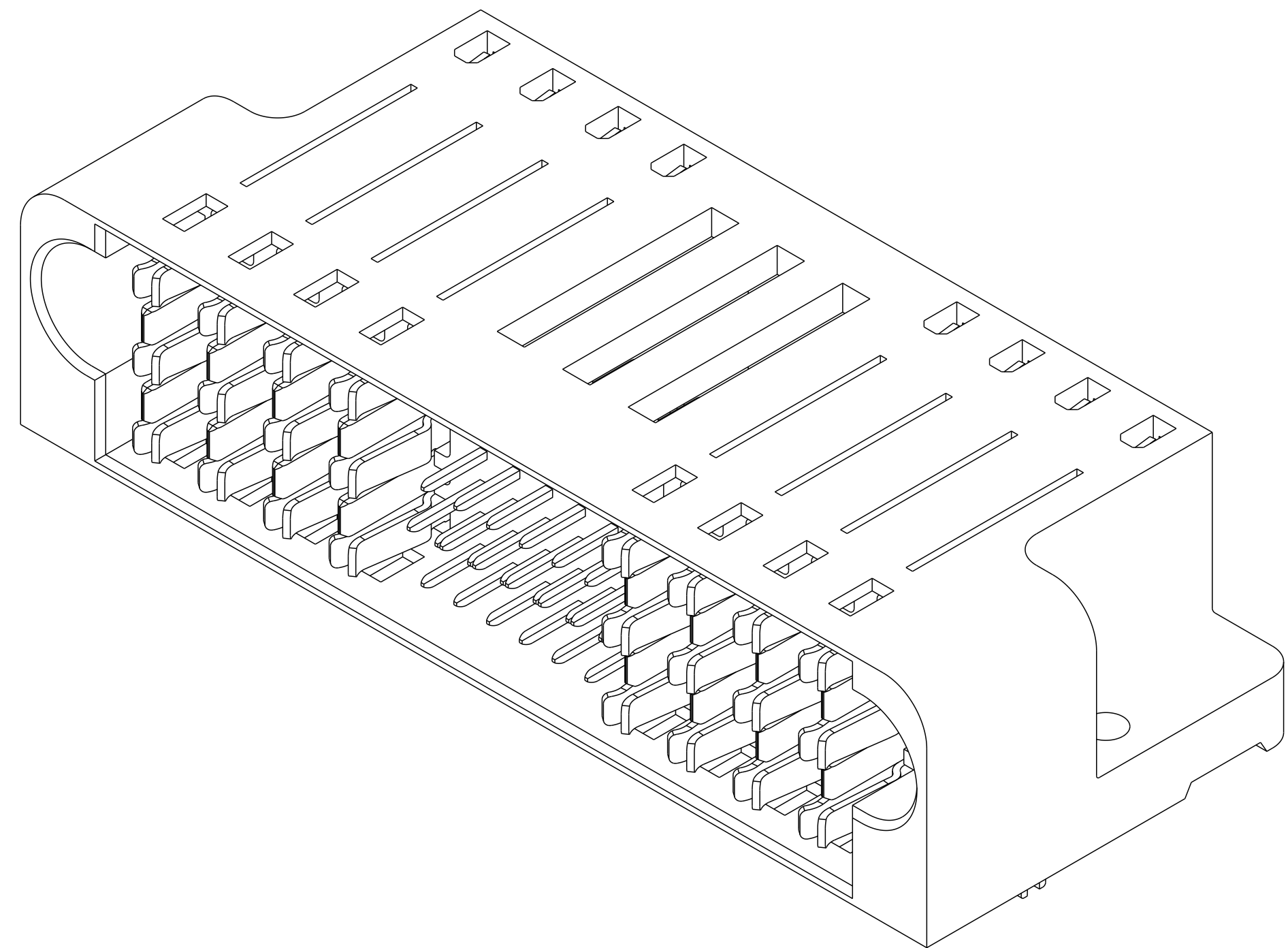
STATUS:Released

Printed: Dec 30, 2014



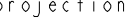
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HCI POWER) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS							
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	NICKEL THICKNESS	GOLD THICKNESS	TIN THICKNESS	SILVER THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
	TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	--	--	--	0.65 - 0.80
	IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	0.9 - 1.5um	--	0.70 - 0.80
	IMMERSION SILVER	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	0.15 - 0.65um	0.70 - 0.80
	COPPER (SEE NOTE 9)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	--	0.70 - 0.80
GOLD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.003 - 0.007	FLASH UP TO 0.0002	--	--	0.69 - 0.80	
C	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 2 (HPC SIGNALS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS							
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	NICKEL THICKNESS	GOLD THICKNESS	TIN THICKNESS	SILVER THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
	TIN-LEAD	1.125-1.175 (Ø.0453±.0010)	0.025-0.050	0.005-0.015	--	--	--	--	0.94 - 1.10 (Ø.040±.003)
	IMMERSION TIN			--	--	--	--	--	
	IMMERSION SILVER			--	--	--	--	--	
	COPPER (SEE NOTE 9)			--	--	--	--	--	
GOLD			--			--	--		
D									D
									E
									F
E									E
									F
F									F

1		2		3		4		5		6		7		8	
PART NUMBER	RETENTION CLIPS	#4 SCREW	DIM A (TAIL LENGTH)	TAIL TYPE											
10077213-001LF	NO	YES	3.43	SOLDER TAIL											
10077213-002LF	NO	YES	4.70	SOLDER TAIL											
10077213-003LF	YES	NO	3.43	SOLDER TAIL											
10077213-004LF	YES	NO	4.70	SOLDER TAIL											



NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
2. CONTACT FINISH (ref GS-12-380 SECTION 5.2)
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-380.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-070.
5. PRODUCT MARKING (PRODUCT NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
6. MINIMUM NOMINAL PCB THICKNESS: 1.6mm
7. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-1073.
8. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C
PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED,
OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
9. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE
NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
10. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
11. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED.

dr	NotFound DuWa	2010/04/28			size	scale
eng	De-Ming Lu	2014/12/27			A2	3:1
chr	-	-			ecn no	ELX-DG-19849-1
appr	Pei-Ming Zheng	2014/12/29	product family	HCI	rel level	Released
	title	R/A HDR ASSY 4P+24S+4P				rev
		HCI POWER CONNECTOR				
www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 5 of 5

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9